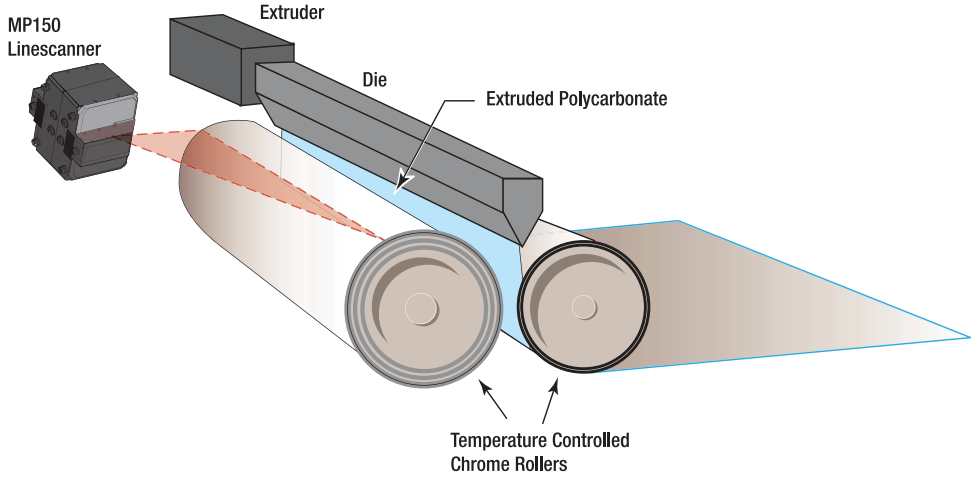
成功应用 69
聚碳酸酯薄膜挤出监测



Q 如何控制聚碳酸酯挤出工艺的薄膜厚度?

A 应用背景介绍

一个用户想去通过控制铬棍的压力和温度来监测和控制聚碳酸酯薄膜的厚度。通过铬棍挤出的聚碳酸酯一般是卖给电子（光盘）和建筑（优质塑料）行业。测量铬棍的温度是比较困难的，因为它表面是光亮的-使用红外测温很难达到很高的精度。经过进一步的讨论，聚碳酸酯产品的温度是可以被Raytek®ES150过程成像系统所测量的。ES150系统的输出可以用于反馈控制铬棍的压力，这是客户最终的目的。

成功的解决方案

- 目前，用户使用处于监测状态的扫描仪。他们比较关注温度曲线，因为铬棍内热空气的压力是通过温度来调整的。如果温度偏差达到了5-8°C/10-15°F，用户将调整铬棍的压力来调整工艺过程。

效益分析

- 使用ES150系统，客户可以调整铬棍压力使挤出的材料最薄，这样可以节省挤出材料的成本。

关键要点

行业
工程和电子

客户最终产品
半渗透膜制造

工艺温度
200-300°C/392-572°F

产品和优势

RAYTES150-P31

- 通过控制厚度的变化实现生产成本降低和质量提升